

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2026-010

北京君正集成电路股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 482,540,723 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	白洁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113	
传真	010-56345001	010-56345001	
电话	010-56345005	010-56345005	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营的影响

报告期内，人工智能技术持续快速发展，生成式人工智能相关技术和应用不断深化，多模态处理能力不断增强，训练与推理效率发展迅速，应用场景不断拓展；与此对应，国内外高性能算力芯片研发持续取得进展，新一代算力芯片在算力性能、能效比及系统集成能力等方面不断提升，为 AI 模型的训练和推理提供了更加有力的支撑；存储则从“数据仓库”升级为“算力协处理器”，为“端、边、云”协同发展提供保障。AI 技术的快速发展和应用普及使得云端大模型训练与推理需求激增，由于 AI 服务器对存储容量和带宽的需求远超普通服务器，AI 基础设施建设需求爆发性增长，面向云端的 AI 存储产品 HBM 产能急剧趋紧，三星、美光、海力士等存储大厂纷纷将更多产能转向 HBM 产品，带来了存储器领域 DRAM 产品产能分布的重构，传统 DRAM 产品产能受到大幅挤压，尤其 DDR4、LPDDR4 产品产能严重不足，从而引发了 DRAM 芯片产品的缺货和涨价潮，存储行业迎来“超级周期”，DRAM 芯片普遍面临价格持续上涨、产能急剧趋紧的情形，供求差距不断扩大。

同时，基础 AI 通用大模型的开源化及相关工具生态的不断完善进一步降低了 AI 技术应用门槛，持续促进着 AI 生态的发展，AI 的应用模式从“云端训练/推理+端侧执行”的模式，逐渐向“云端训练/批量推理+边侧中算力推理+终端轻推理”模式演进，推动了对边侧、端侧算力的需求增长。在 AI 技术持续发展的推动下，集成电路产业迎来了新的应用市场机遇，高性能计算、数据中心、AI PC、AI 手机、智能汽车等下游应用需求持续增长，成为集成电路产业增长的核心引擎。

综合上述影响因素，报告期内全球集成电路产业整体延续增长趋势，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）及美国半导体行业协会（SIA）发布的 2025 年行业数据，2025 年全球半导体市场规模继续保持增长态势，数据中心及高性能计算相关应用成为行业增长的重要驱动力之一，2025 年全球半导体市场销售额为 7917 亿美元，同比增长 25.6%，创历史新高；中国市场销售额首次突破 2100 亿美元，同比增长超 15%，占全球比重保持在三成左右。

从行业政策方面，在技术革命与地缘格局双重推动下，集成电路产业越来越成为信息产业发展的关键性、基础性产业，其战略地位进一步凸显，全球产业政策支持力度持续加码，全球主要国家和地区纷纷出台相关产业政策，从产业投入、政府补贴、人才培养、税收减免等多个层面支持本国集成电路产业的发展，强化本土产业链竞争力，集成电路领域的技术创新与自主可控成为各国产业战略的核心诉求。我国对集成电路产业一直高度重视，《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策》延续实施至 2030 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等国家战略规划中持续强调推动集成电路等关键核心技术领域的发展，多地地方政府亦陆续出台相关政策支持本地集成电路产业的发展。

公司主要产品线为存储芯片、计算芯片和模拟与互联芯片，其中存储芯片主要面向汽车、工业等领域，随着 2025 年汽车、工业等行业市场逐渐复苏，销售收入同比实现了增长，其中在存储大周期的推动下，公司 2025 年第四季度存储芯片开始呈现出更强的需求趋势。计算芯片主要面向智能安防、二维码设备、生物识别、智能门锁、打印机、智能家居

电等端侧消费类产品市场，随着市场需求的增长以及公司芯片产品进入更多应用领域，报告期内销售收入同比有所增长。公司模拟与互联芯片受益于汽车等市场的恢复及新产品的不断推出，报告期内实现了一定的同比增长。随着高性能计算、大数据存储、汽车电子等新兴应用端需求的持续发展，以及 AI 技术的应用在各领域的加速普及和纵深发展，全球集成电路行业长期来看将持续保持良好的发展趋势，公司将不断进行新产品的开发、升级和市场的推广工作，及时抓住 AI 驱动下的行业机会，推动公司经营业绩的不断成长。

(2) 主流技术水平情况、市场需求变化情况及对公司的影响

公司的芯片产品根据功能和应用领域主要分为存储芯片、计算芯片、模拟与互联芯片。近几年来，公司主要芯片产品普遍面临更高性能、更高集成度和更低功耗等市场需求变化。为应对这一市场需求，公司不断加强技术研发，持续优化相关技术，不断提高新产品的技术水平。

公司存储芯片和模拟与互联芯片主要面向汽车电子、工业制造、医疗设备、通信设备等行业市场，从技术和产品性能的要求上，车规级和工业级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费级芯片更为严格。在温度适应能力方面，消费级一般为 0~70 摄氏度、工业级一般为-40~85 摄氏度、车规级一般为-40~125 摄氏度；使用寿命方面，消费级一般为 1-3 年，车规级及工业级则可能达到 7-15 年或以上；车规级及工业级芯片对振动、冲击、EMC 电磁兼容性能等也有着更高要求。公司多年来专注于工业和汽车等高可靠性领域的应用，在易失性存储领域和非易失性存储领域均有多年丰富的行业经验。在照明驱动和车载互联等技术方面，也拥有丰富的技术积累。公司在产品温度适应性、品质控制等方面形成了一套严格的研发和测试流程，能够充分满足上述市场的要求。随着汽车智能化的发展，汽车对存储芯片的需求越来越多，对 LED 驱动芯片的需求种类也在不断丰富，同时，车规互联芯片的需求也在不断增加，公司在存储芯片和模拟、互联芯片领域持续进行产品研发，不断推出新的产品型号，满足市场对相关产品不断发展的需求。

在算力芯片性能不断提升，大语言模型的参数规模迅速增长的情况下，AI 技术在智能手机、PC、服务器、汽车等各个领域的应用不断拓展，当前 AI 模型和高性能计算对 DRAM 的带宽需求正以每年倍数级的速度增长，3D DRAM 等新型存储芯片可有效满足 AI 芯片与高性能计算芯片对 DRAM 高带宽、大容量的需求，市场对包括 3D DRAM 在内的 AI 存储芯片的需求呈现出快速增长态势。公司拥有深厚的 DRAM 设计经验和丰富的产业资源，具有发展 3D DRAM 产品的基础。报告期内，公司继续推进 3D DRAM 的研发，公司将面向 AI 存储领域持续进行技术投入，积极跟进 AI 存储市场的需求，努力抓住新兴市场机会。

公司计算芯片主要面向智能安防、泛视觉和智能物联网等市场，在这些市场中，AI 已得到越来越多的普及，从应用上，云端的部分算法和应用逐渐向端侧迁移，终端产品算力需求不断提高；同时，信息处理需求的增加也要求芯片运算能力不断提高。公司在计算技术方面拥有较强的技术能力，掌握了多项自主创新的关键性核心技术，能够根据市场需求变化持续推出新的芯片产品。近几年来公司在 AI 技术领域持续投入，公司自研的 AI 算力引擎处理能力不断增强，AI 算法技术不断丰富，公司根据市场需求推出具有不同 AI 性能的芯片产品，很好地满足了市场对 SoC 芯片在 AI 性能方面不同层级的需求。针对目前不同应用领域对芯片算力需求不断加大的情形，公司持续加强算力技术的研发，规划了面向端

侧更高算力性能的计算芯片产品，以寻求更多的市场发展机会；同时，针对 AI 技术持续渗透下部分消费电子产品、白色家电、工业控制等设备对 MCU 芯片性能升级的需求，公司启动了 AI MCU 产品的研发，报告期内，公司 AI MCU 产品于四季度样品回片，目前正处于测试验证阶段。

(3) 核心技术以及成本控制等因素的竞争情况和公司综合优劣势

公司产品主要面向两大类市场。第一类是智能硬件、智能安防、泛视觉等消费类市场，这个市场因空间广阔、发展迅速而获得了手机芯片厂商、无线芯片厂商、多媒体芯片厂商、MCU 等众多厂商的参与，竞争非常激烈；第二类是汽车电子、工业制造、医疗设备、通讯设备等行业市场，这个市场面临美光、三星、海力士、英飞凌、华邦等国际半导体企业的竞争，竞争也比较激烈。在激烈的市场竞争中，自主可控的核心技术和产品的成本控制一直是公司重要的竞争优势之一。

公司通过多年的研发投入，在嵌入式 CPU 技术、视频编解码技术、影像信号处理技术、神经网络处理器技术、AI 算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术，且技术领先、自主可控。公司在关键核心技术上的自主设计大大降低了芯片在设计、生产和销售等阶段的相关技术授权费用，从而有利于公司的成本控制；同时，关键技术的自主研发还可以在设计芯片时针对特定应用市场进行定制设计而避免不必要的冗余，从而进一步节省了成本；此外，在研发中，公司紧密跟踪先进工艺制程的发展情况，选择适合产品需求的最经济合理的工艺节点，这也是公司对产品成本控制的重要手段之一。

近几年来，随着 AI 技术的快速发展和渗透，对 AI 相关技术的积累逐渐成为市场竞争的关键因素，围绕 AI 发展的机遇，公司在存储技术和计算技术两大领域均有布局，存储技术方面，公司启动了 3D DRAM 的研发，包括 3D DRAM 产品中算力 SoC 和 DRAM 的接口单元 base die 的研发；计算技术方面，公司神经网络处理器技术不断往端侧更高算力演进，公司 AI 算法不断丰富，可应用于多种场景。公司自主创新的核心技术和产品突出的性价比优势，使公司的市场销售在近几年来保持了良好的发展势头。在存储器芯片领域，公司的 SRAM、DRAM、Nor Flash 等产品在全球车规存储市场均占据重要的产业地位；在智能视觉芯片领域，公司发展迅速，目前已成为国内安防监控市场的主流供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	13,573,205,293.47	12,926,945,100.27	5.00%	12,742,026,939.41
归属于上市公司股东的净资产	12,448,858,248.59	12,053,926,365.37	3.28%	11,791,223,913.71
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	4,741,007,597.96	4,212,625,881.35	12.54%	4,530,925,656.37
归属于上市公司股东的净利润	376,226,023.06	366,202,096.74	2.74%	537,254,388.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,053,053.11	311,947,507.44	-0.93%	491,438,067.99
经营活动产生的现金流量净额	622,602,778.07	363,454,929.15	71.30%	558,151,743.82
基本每股收益（元/股）	0.7803	0.7604	2.62%	1.1156
稀释每股收益（元/股）	0.7781	0.7592	2.49%	1.1156
加权平均净资产收益率	3.06%	3.08%	-0.02%	4.67%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,060,232,459.55	1,188,879,921.77	1,187,388,497.87	1,304,506,718.77
归属于上市公司股东的净利润	73,904,992.30	129,211,333.71	52,627,199.90	120,482,497.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,347,906.29	94,566,124.13	40,391,779.48	107,747,243.21
经营活动产生的现金流量净额	175,151,109.32	257,332,207.19	77,889,830.69	112,229,630.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,447	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
刘强	境内自然人	8.39%	40,475,544.00	30,356,658.00	不适用	0.00			
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	32,573,848.00	0.00	不适用	0.00			
北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.60%	31,857,875.00	0.00	不适用	0.00			
李杰	境内自然人	3.71%	17,917,785.00	14,038,339.00	质押	5,720,000.00			
戴思元	境内自然人	2.39%	11,523,938.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	10,331,965.00	0.00	不适用	0.00			
冼永辉	境内自然人	2.06%	9,928,659.00	7,452,269.00	不适用	0.00			
张紧	境内自然人	1.81%	8,725,685.00	6,994,264.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	6,563,892.00	0.00	不适用	0.00			
中信银行股份有限公司一永赢先锋半导体	其他	1.28%	6,200,000.00	0.00	不适用	0.00			

智选混合型发起式证券投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

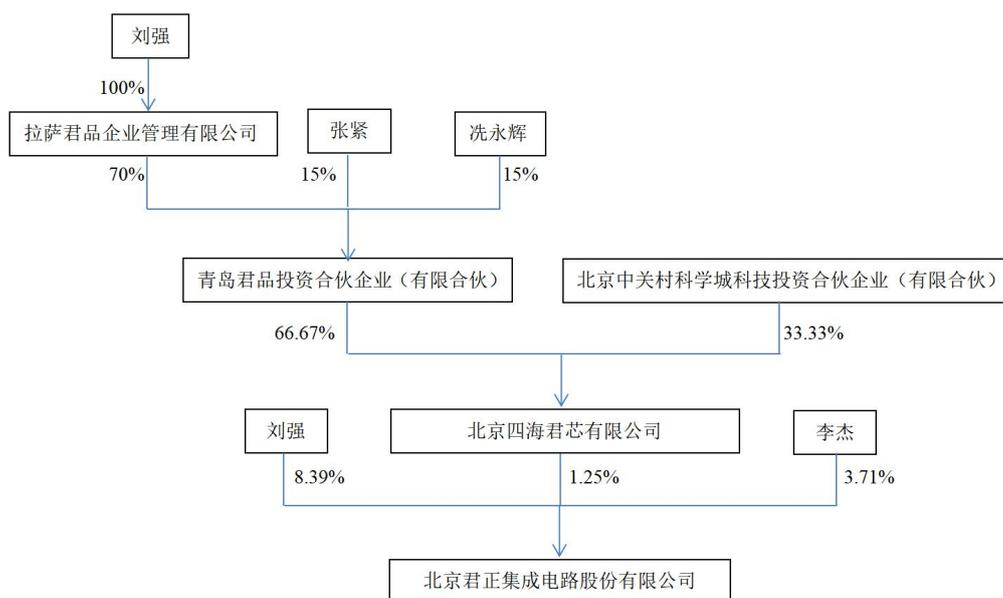
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

公司于 2024 年推出《2024 年限制性股票激励计划》，2025 年 4 月 18 日，公司就 2024 年限制性股票激励计划的预留部分，向符合条件的 57 名激励对象授予 40.00 万股第二类限制性股票，该事项于 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025 年 5 月，2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，公司为符合资格的激励对象办理了第二类限制性股票归属事项。2025 年 6 月，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的限制性股票上市流通，该事项于 2025 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议和 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了相关议案。2025 年 9 月 15 日公司向香港联交所递交了上市申请，并于 2025 年 9 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强

二〇二六年三月二十六日